

# YourPCB PCB 製程能力表

修正版 PCB 製程能力總覽，適用於工程審查、DFM 與國際客戶詢價評估。

製程能力項目	標準製程能力	進階製程能力	高階/工程製程能力
材料	FR-4, High-Tg FR-4, Polyimide, Low Dk, BT-Resin	FR-4, High-Tg FR-4, Polyimide, Low Dk, BT-Resin, PTFE	FR-4, High-Tg FR-4, Polyimide, Low Dk, BT-Resin, PTFE
阻抗控制公差	+/-10%	+/-8%	+/-5%
內層線寬	0.003" / 0.075mm	0.0024" / 0.06mm	0.0016" / 0.04mm
外層線寬	0.0036" / 0.09mm	0.0028" / 0.07mm	0.0024" / 0.06mm
BGA 間距支援	0.016" / 0.4mm	0.012" / 0.3mm	0.008" / 0.2mm
化金厚度	1.2u" / 0.03um	8u" / 0.2um	10u" / 0.25um
電鍍金厚度	20u" / 0.5um	50u" / 1.27um	60u" / 1.5um
層數	最高 30 層	最高 50 層	最高 60 層
最小機械鑽孔	0.006" / 0.15mm	0.005" / 0.125mm	0.003" / 0.075mm
最大生產板尺寸	24.0" x 26.0" / 610 x 660mm	24.4" x 28.3" / 620 x 720mm	24.4" x 28.3" / 620 x 720mm
最大板厚	0.189" / 4.8mm	0.236" / 6mm	0.275"+ / 7mm+
高縱橫比支援	最高 24:1	最高 30:1	最高 35:1
對位能力	0.003" / 0.075mm	0.0016"-0.002" / 0.04-0.05mm	0.0012"-0.0016" / 0.03-0.04mm
特殊製程	塞孔、背鑽、雷射鑽、1+N+1 HDI	塞孔、背鑽、雷射鑽、2+N+2 HDI	塞孔、背鑽、雷射鑽、4+N+4 HDI